

►重要提示

这里所有叙述, 技术信息和推荐均基于我们认为可靠实验。此文代替所有保证, 明示或暗示的包括可卖性和用途的适用性。销售商, 制造商仅负责更换被证明有缺陷的产品。使用以前, 用户需决定用于其用途的产品的适用性。用户承担这里涉及的各种风险和责任。销售商和制造商不承担使用本公司产品所造成任何损失或损坏的法律责任, 包括直接的, 附带的或由此产生的利润或产值损失。

►补救措施和责任限制

在kenseer 产品被证实有瑕疵的情况下, kenseer提供的补救方式为包退, 包修或包换; kenseer对于无视法律声明而造成的损失或损害不承担责任, 包括疏忽, 担保或严格责任。

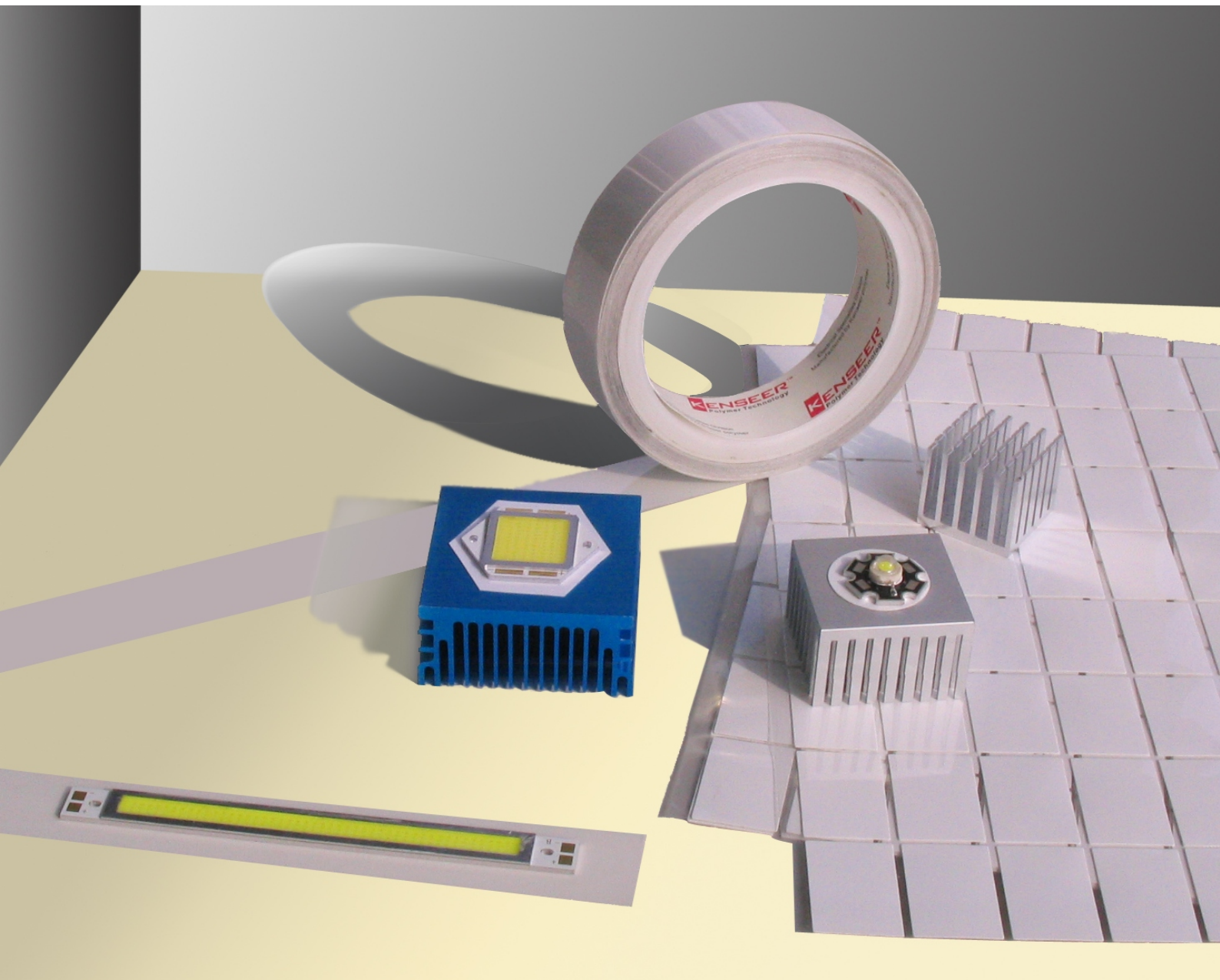
肯舍尔电子材料有限公司

北京昌平科技园区超前路5号 邮编: 102200
电话: (8610)-51292882
传真: (8610)-51292842
电子信箱: info@kenseer.com
www.kenseer.com

Kenseer Electronic Materials Limited

No.5 Chaoqian Road Changping Science Park Beijing 102200 China
Tel: (8610)-51292882
Fax: (8610)-51292842
E-mail: info@kenseer.com
www.kenseer.com

Thermally Conductive Adhesive Transfer Tapes
KENBOND™ 1000系列导热双面胶带
为大功率LED提供最佳的导热粘接封装



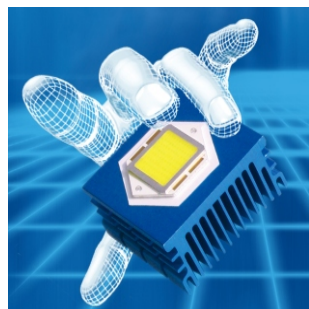
KENBOND™ 1000系列导热双面胶带

Thermally Conductive Adhesive Transfer Tapes

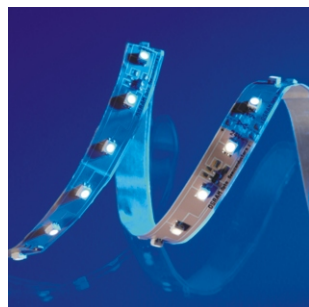
Increasing Customer
为客户提供更高价值 **VALUE**



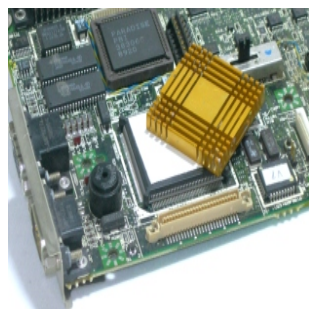
LED铝基板与散热器的导热粘接固定



大功率LED与散热器的导热粘接固定



软性LED光带的导热粘接固定



功率芯片与散热器的导热粘接固定

► 概述

Kenbond 1000系列导热双面胶带是一种由高性能丙烯酸压敏胶填充高导热陶瓷粒子涂布于玻璃纤维布两面或无基材而制成。

Kenbond 1000系列导热双面胶带在电子器件和散热片之间提供高效的导热通道,使其电子器件与散热器之间不再需要机械固定和液体胶粘剂固化固定。

▶ 特性

kenbond 1000系列导热双面胶带使用时只需轻压即可立即粘接;其粘接性能,粘接强度随时间和温度升高而增强。Kenbond 1000系列导热双面胶带可模切任何形状的产品,并可预先贴在一个表面上以便将来粘合使用。

► 应用

Kenbond1000系列导热双面胶带应用于芯片,柔性电路板及大功率晶体管和散热片或其它冷却装置的粘接。

如:

大功率LED铝基板与散热器的粘接安装

安装弹性加热薄片

安装温度显示膜

安装热电冷却模具

散热器于微处理器的粘接

柔性电路与散热装置的粘接

功率晶体管与印刷电路板粘接

► 技术参数

项目	Kenbond 1005	Kenbond 1015	Kenbond 1020	测试方法
外观	白色	白色	白色	目测
基材	无	玻纤布	玻纤布	
玻纤布厚度mm		0.1	0.1	ASTM374
总厚度mm	0.05	0.15	0.2	ASTM374
导热系数W/m.k	0.8	0.8	0.8	ASTM D5470
热阻抗℃in ² /w	0.1	0.23	0.3	ASTM D5470
粘接强度N/cm	4.1	5.3	6.5	ASTM D1002
击穿电压KVAC	1.0	2.5	3.0	ASTM D149
体积电阻ohm/cm	3X10 ¹³	3X10 ¹³	3X10 ¹³	ASTM D257
适用温度范围℃	-20~130	-20~130	-20~130	
贮存期（月）	24	24	24	